



説明内容

HORIBA

- ・ 2014年12月期 上期 決算概要
- ・ 2014年12月期 通期 業績予想
- ・ セグメント別詳細説明
- ・ 経営上の取組事項

< 免責事項 >

本プレゼンテーション資料には、株式会社堀場製作所の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予測です。また経済動向、他社との競争状況、為替レートなどの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レート、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 2

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

説明内容

HORIBA

- ・ 2014年12月期 **上期** 決算概要
- ・ 2014年12月期 通期 業績予想
- ・ セグメント別詳細説明
- ・ 経営上の取組事項

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 3

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

2014
上期実績

上期決算概要

HORIBA

半導体と環境・プロセス事業の好調を受け、増収増益

P&L

- ◆ 円安による営業利益押し上げ効果は、売上高 +35億円、営業利益 +6億
- ◆ 1Q: 昨年度比で半導体と環境好調
- ◆ 2Q: 自動車計測と半導体の一時的な出荷減、科学は出荷増で利益回復

B/S

- ◆ 売掛債権の回収などが進み、前年末比で総資産は▲33億円の1,859億円
- ◆ 純資産は▲14億円で、自己資本比率は61%

CF

- ◆ 利益計上、売上債権減などで営業CF +66億円
 - ◆ 設備投資などにより投資CF ▲58億円
 - ◆ 配当金支払などにより財務CF ▲4億円
- } フリーCF +7億円

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 4

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

2014 上期実績		上期連結実績			HORIBA (単位:億円)	
	2013年	2014年				
	上期実績	上期実績	前年比	(5/9予想)		
売上高	596	679	+82 (+13.8%)	720		
営業利益	39	56	+16 (+42.5%)	55		
営業利益率	6.7%	8.3%	+1.6P	7.6%		
経常利益	37	51	+13 (+37.4%)	53		
当期純利益	25	25	+0 (+2.5%)	32		

Explore the future Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific HORIBA 5
© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

2014
上期実績

説明内容

HORIBA

- ・ 2014年12月期 上期 決算概要
- ・ 2014年12月期 **通期** 業績予想
- ・ セグメント別詳細説明
- ・ 経営上の取組事項

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 7

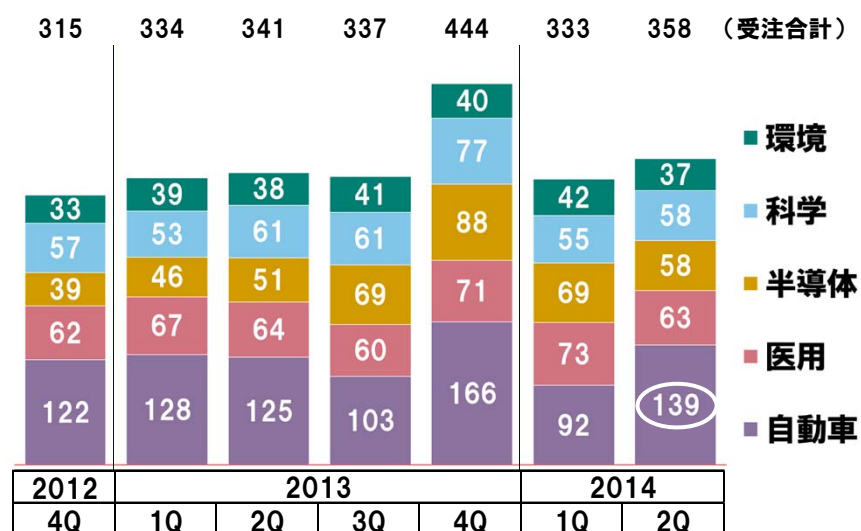
© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

2014
通期予想

受注トレンド

HORIBA

(単位:億円)



Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 8

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

2014 通期予想		連結業績通期予想			HORIBA (単位:億円)	
	2013年	2014年				
	実績	5/9予想	今回予想	前年比		
売上高	1,381	1,500	1,500	+118 (+8.6%)		
営業利益	137	150	150	+12 (+9.2%)		
営業利益率	9.9%	10.0%	10.0%	+0.1P		
経常利益	130	145	145	+14 (+11.1%)		
当期純利益	89	90	90	+0 (+0.0%)		
ROE	8.4%	7.7%	7.7%	-		
為替レート	2013年度実績レート 2014年度想定レート		US\$ = 97.73円 US\$ = 100円		EUR = 129.78円 EUR = 135円	

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA9

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

2014 通期予想		セグメント別業績予想				HORIBA (単位:億円)		
【前年同期/前回予想比】								
	売上高				営業利益			
	2013年 実績	2014年 5/9予想	2014年 今回予想	5/9 予想比	2013年 実績	2014年 5/9予想	2014年 今回予想	5/9 予想比
自動車	495	545	550	+5	42	52	55	+3
医 用	268	285	275	▲10	24	25	20	▲5
半 導 体	241	270	270	-	48	50	50	-
科 学	229	245	245	-	9	10	10	-
環 境	147	155	160	+5	12	13	15	+2
合計	1,381	1,500	1,500	-	137	150	150	-

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

HORIBA10

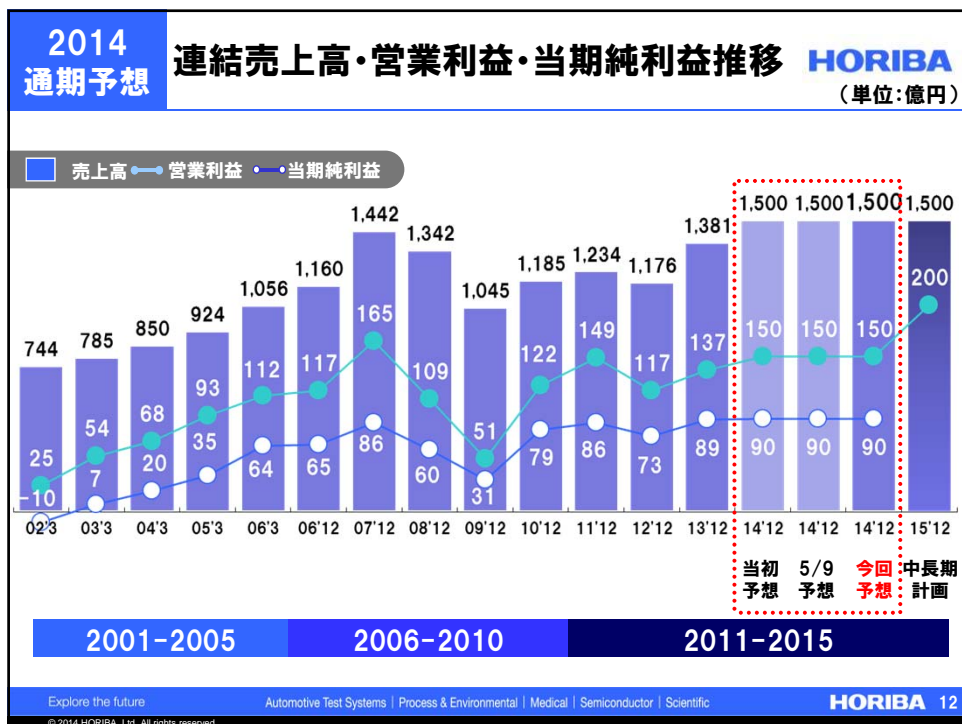
2014 上期・下期		下期の業績予想					HORIBA (単位:億円)	
売上高	2013年			2014年			下期のセグメント別業績予想	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期		
自動車	203	292	495	212	337	550	【自動車】	
医 用	131	137	268	135	139	275	・昨年以上に下期に出荷集中	
半 導 体	99	142	241	131	138	270	・利益も同様	
科 学	99	129	229	116	128	245	【医用】	
環 境	63	83	147	82	77	160	・アジア大口案件遅延	
合 計	596	784	1,381	679	820	1,500	【半導体】	
営業 利益	2013年			2014年			・2Q後半は一時的にスローダウン	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	・3Qから回復想定	
自動車	12	30	42	8	46	55	【科学】	
医 用	10	13	24	9	10	20	・海外中心に下期出荷集中	
半 導 体	15	32	48	26	23	50	【環境】	
科 学	▲1	11	9	0	9	10	・上期は日本、アジア好調	
環 境	3	9	12	10	4	15	・下期はスローダウンを予想	
合 計	39	97	137	56	93	150		

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

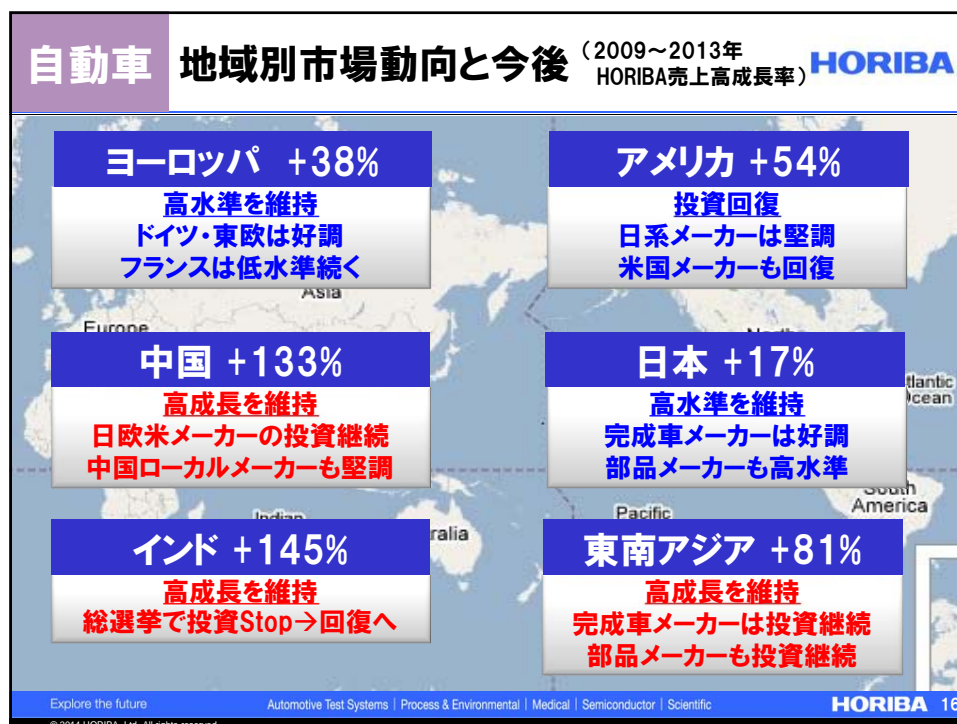
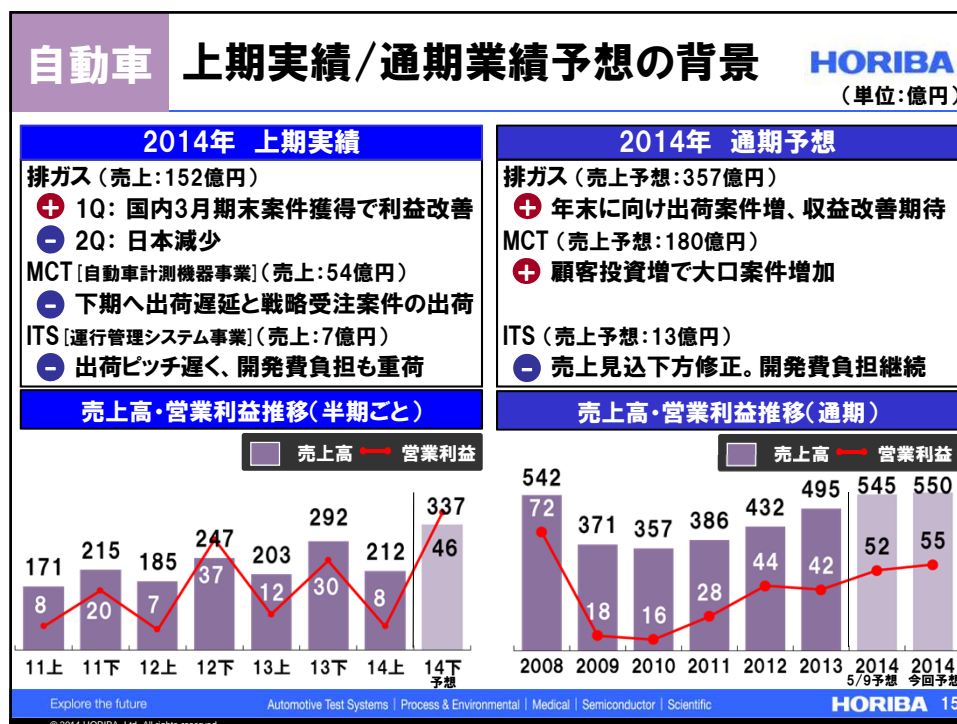
HORIBA 11

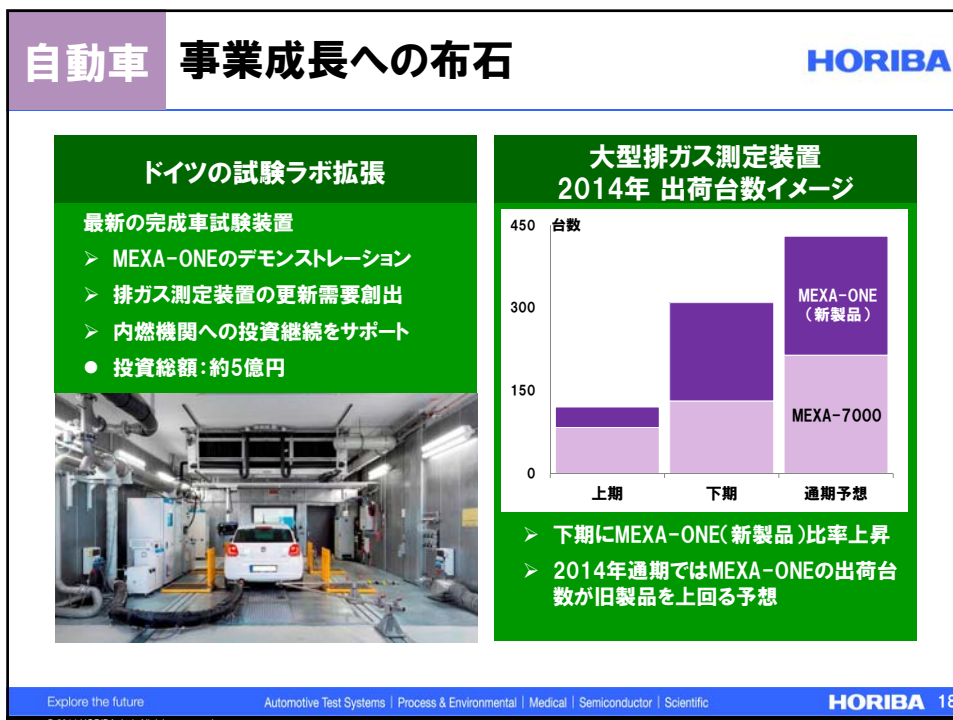
© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

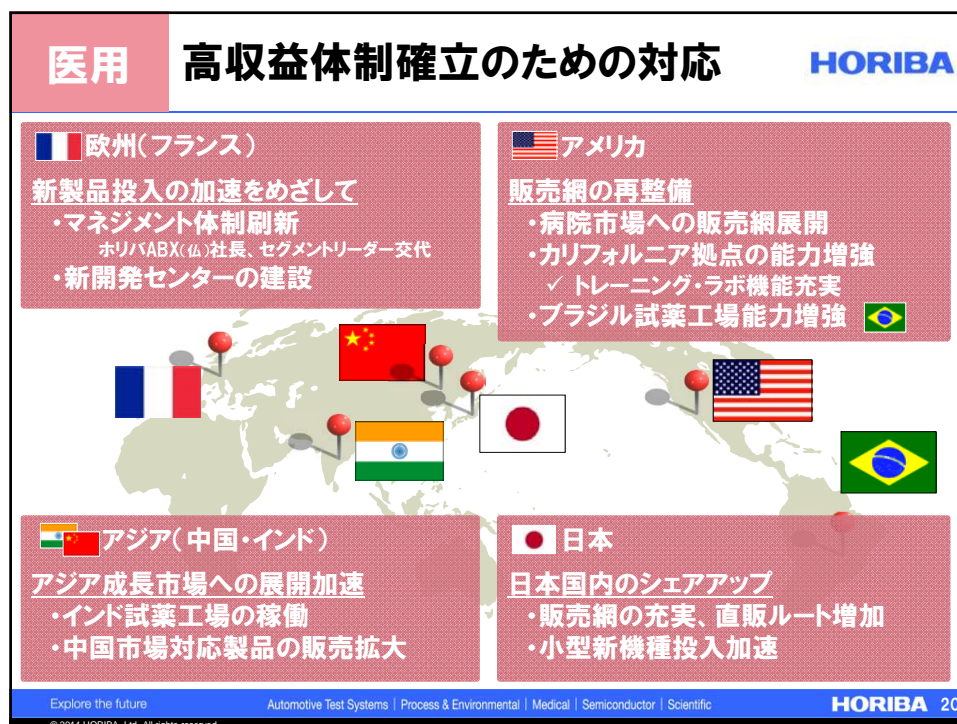
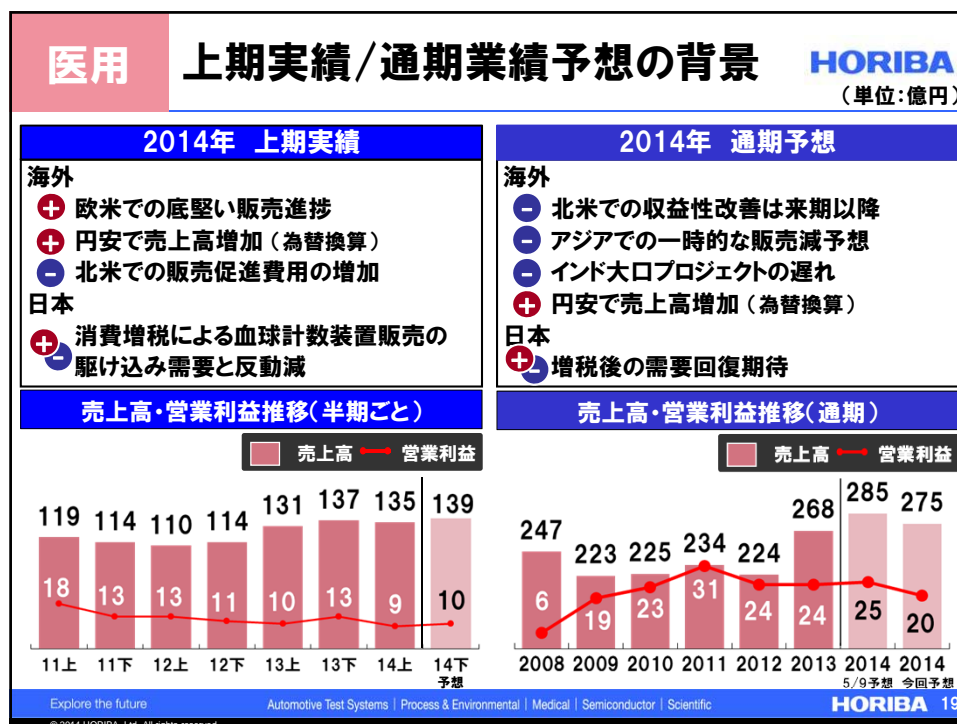


- ・ 2014年12月期 上期 決算概要
- ・ 2014年12月期 通期 業績予想
- ・ **セグメント別詳細説明**
- ・ 経営上の取組事項

次ページへ







半導体

上期実績/通期業績予想の背景

HORIBA

(単位:億円)

2014年 上期実績

マスフローコントローラー

- ⊕ 1Q:前年比で大幅増、シェアアップ実現
- ⊖ 2Q:シリコン向け徐々にスローダウン
- ⊕ 太陽電池やLED向けで回復の兆し

薬液モニター

- ⊖ 大口案件少なく低調

2014年 通期予想

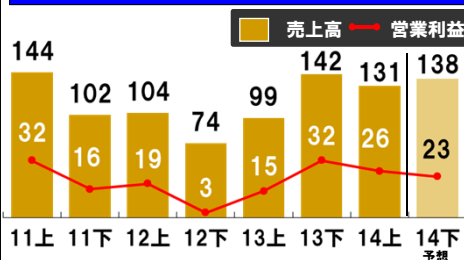
マスフローコントローラー

- ⊖ 2Q後半が一時的なボトム
- ⊕ 3Qより回復期待
- ⊕ 太陽電池やLED向けは増加期待

薬液モニター

- ⊕ 徐々に需要増加、大口案件期待

売上高・営業利益推移(半期ごと)



売上高・営業利益推移(通期)



Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 21

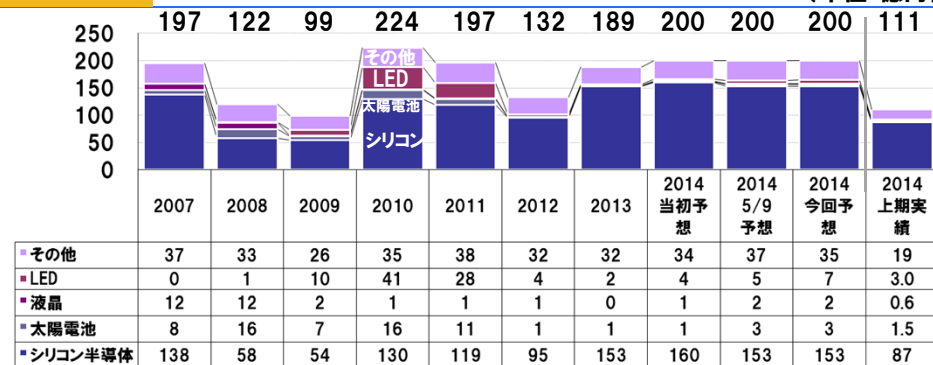
© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

半導体

マスフローコントローラーの用途別売上高

HORIBA

(単位:億円)



「アプリケーション別トピックス」

- ☀️ シリコン半導体・・・台湾/韓国向け中心。2Q後半はスローダウンも3Qより回復期待
- ☀️ 太陽電池 ……装置メーカーからの受注は徐々に増加
- ☀️ LED(MOCVD)・・・大手装置メーカーの在庫一巡により需要は徐々に回復傾向

市場 | 2012年=43% 2013年=48%

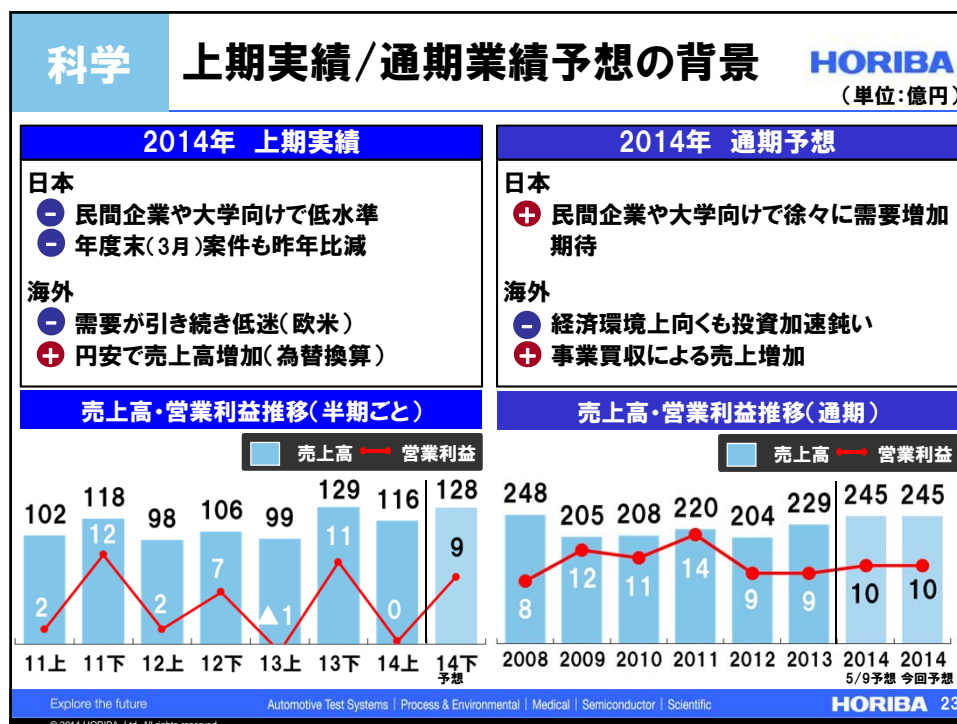
シェア | 2014年1-6月=52% (台湾や韓国最終ユーザーの需要取り込みでシェアアップ実現)

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 22

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.



科学 ライフサイエンス分野への注力 HORIBA

① ライフサイエンス分野で新たなビジネスモデルへ挑戦
 ➢ 注力分野: エネルギー、自動車、バイオ、創薬、など
 ➔ 顧客との共同プロジェクトによる独自の製品展開を加速

② 蛍光分光事業買収(米国フォトン・テクノロジー・インターナショナル社)
 ➢ 売上高: 8億円(2013年実績) 買収: 2014年2月
 ➢ 次世代医薬品開発、病院、農業・食品分野に強み
 ➔ バイオ市場やミドルレンジ市場での拡販めざす

注目新製品

ラマン分光分析装置
「AFM-ラマン」

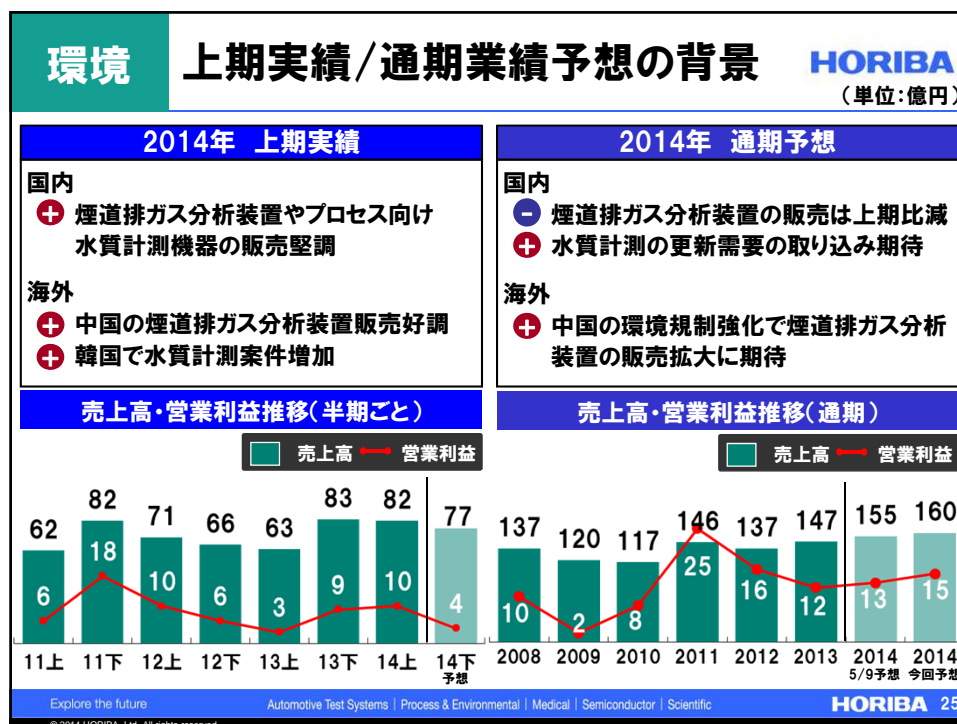
(対象市場) 二次電池や半導体などのナノ分野の材料開発

「JASIS 2014」に出展(旧分析展)
 ・開催日: 9月3～5日 ・場所: 幕張メッセ

http://www.jasis.jp/2014/

HORIBAブースにて「投資家向けツアー」開催
9月5日午前 実施予定

Explore the future Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific **HORIBA 24**
© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.



環境

アジアでの需要拡大への対応

HORIBA

煙道排ガス分析装置の需要拡大

対象市場: 電力、石油化学、鉄鋼、食品などの工場/プラント

市場動向: 大気汚染に対する中国政府の規制強化

- 政府による民間企業の監視範囲拡大
- ハイエンド分析装置の需要増加

《HORIBAの中国での煙道排ガス分析装置》

- ・安定性と故障率の低さが現地で好評
- 日本で10万台以上の実績
- ・上海工場での高効率生産
- 中国での月間生産台数は昨年比4倍

「煙道排ガス分析装置 ENDAシリーズ」

発電所や工場などでの煙道排ガスに含まれる多種多様なガスを連続測定する監視システム

Explore the future
Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific
HORIBA 26

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

- ・ 2014年12月期 上期 決算概要
- ・ 2014年12月期 通期 業績予想
- ・ セグメント別詳細説明
- ・ **経営上の取組事項**

アメリカでの体制強化(北米)

米州本社を移転集約・事業統括機能を強化

- カリフォルニア・アーバイン
- 設立: 1973年(40周年)
- 集約(米国事業の強化)
 - 米州ヘッドクォーターとしての管理機能強化
 - 医用事業の販売サポート体制の強化



自動車事業の生産工場増強

- デトロイト郊外
- 排ガス(アナーバー): 工場拡張
- MCT(トロイ): 自社所有へ
- 投資合計: 6億円
 - 自動車メーカーの開発需要への対応
 - MEXA-ONE(新製品)へのリブレース加速へ



アメリカでの体制強化(ブラジル)

HORIBA

ブラジルの試薬工場増強

- ブラジル・サンパウロ市郊外
- 医用試薬生産の拡大(生産能力4倍に)
- 血液検査装置需要の拡大に対応



Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 29

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

日本での投資加速、拠点再整備

HORIBA

堀場エステック京都福知山テクノロジーセンター

- ・セグメント: 半導体 ・投資総額: 10億円
- ・稼働: 2013年12月
- ・目的: 流体計測制御及び気化技術の研究



HORIBA BIWAKO E-HARBOR

- ・セグメント: 自動車、環境 ・投資総額: 100億円
- ・稼働: 2015年秋予定
- ・目的: ガス分析事業の開発・生産拠点



堀場エステック阿蘇工場

- ・セグメント: 半導体、医用
- ・稼働: 2013年12月(現在の規模に)
- ・目的: マスフローコントローラー
血球計数装置・試薬の生産



HORIBA最先端技術センター

- ・セグメント: 半導体 ・投資総額: 30億円
- ・稼働: 2014年12月予定
- ・目的: 半導体センサーの開発



～京都本社再整備へ～
日本の“ものづくり”の強みを活かす

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 30

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

株主還元政策および今期の配当金について **HORIBA**

株主還元政策

- 配当金 + 自社株取得 = 連結純利益 × 30% を目処
- 残りは戦略的投資資金として内部留保(設備投資・M&A)

配当実績 & 予想

- 2012年実績 50円 [中間15円、期末35円]
 - うち、創立60周年記念配当10円
- 2013年実績 60円 [中間18円、期末42円]
 - 配当原資 = 連結純利益89億円 × 30%
- 2014年予想 64円 [中間25円、期末39円]
 - 配当原資 = 連結純利益予想90億円 × 30%

Explore the future

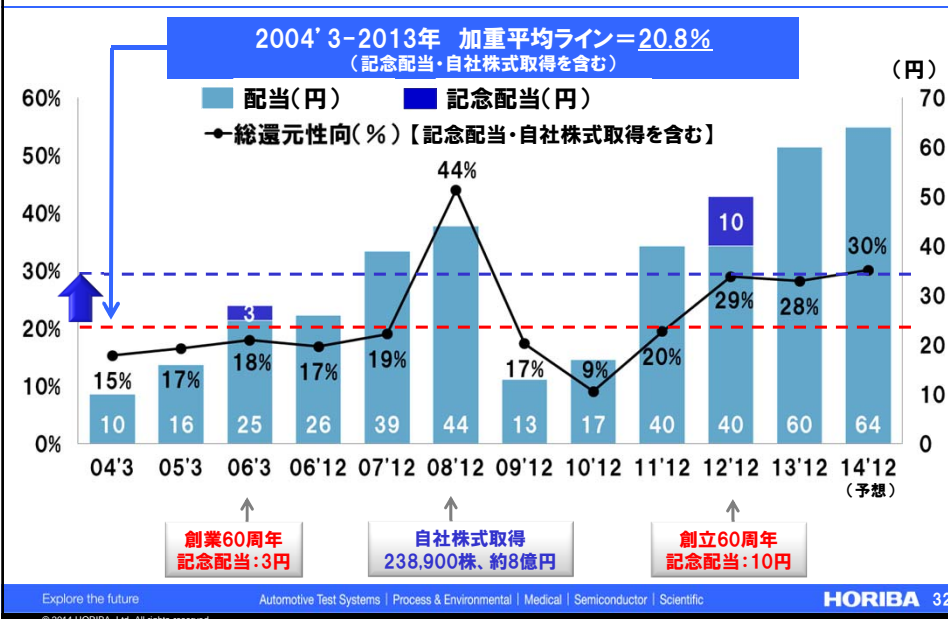
Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 31

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

配当金・総還元性向の推移

HORIBA

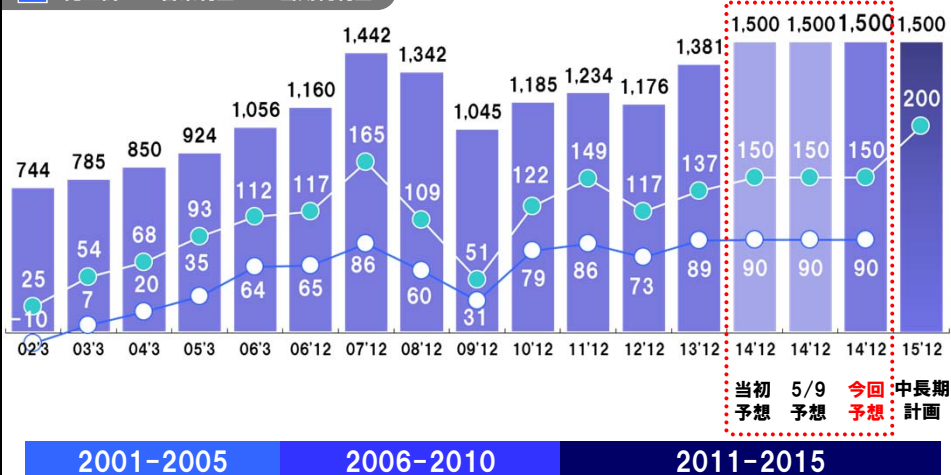


中長期経営計画の進捗状況

HORIBA

(単位: 億円)

■ 売上高 ● 営業利益 ● 当期純利益



Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 33

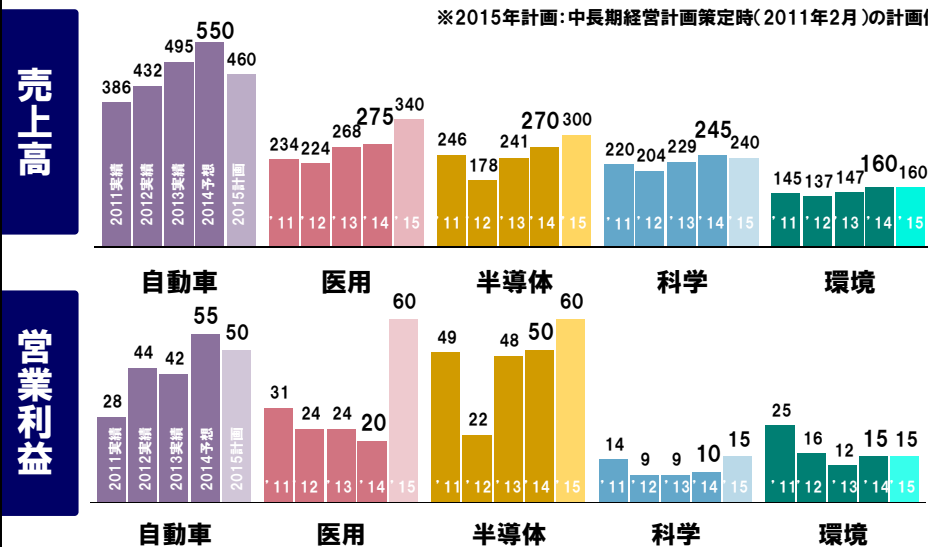
© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

中長期経営計画の進捗状況 (セグメント別)

HORIBA

(単位: 億円)

※2015年計画: 中長期経営計画策定時(2011年2月)の計画値



Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 34

© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

